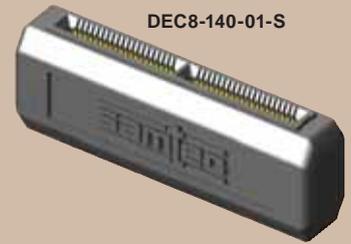


HSEC8-130-01-S-D-EM2



DEC8-140-01-S

# 0,80mm 卡插口 HSEC8-EM , DEC8 系列

## 技术规格

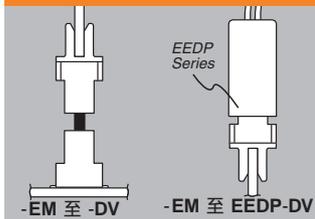
如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 [www.samtec.com?HSEC8-EM](http://www.samtec.com?HSEC8-EM)

绝缘材料:  
液晶聚合物  
触点: 镀铜  
电镀: 在 50μ" (1,27μm) 的镍上镀金或镀锡  
额定电流:  
30°C 温升时为 3.1A  
工作温度:  
-55°C 至 +125°C  
卡插入深度:  
(3,15mm) .125" 标称  
最大加工温度:  
230°C 下持续 60 秒, 或!  
260°C 下持续 20 秒, 3 次  
可无铅焊接: 是  
符合 RoHS 规范要求: 是



注: 所需的 PCB 厚度为 (1,60mm) .062" ± (0,08mm) .003"

## 应用



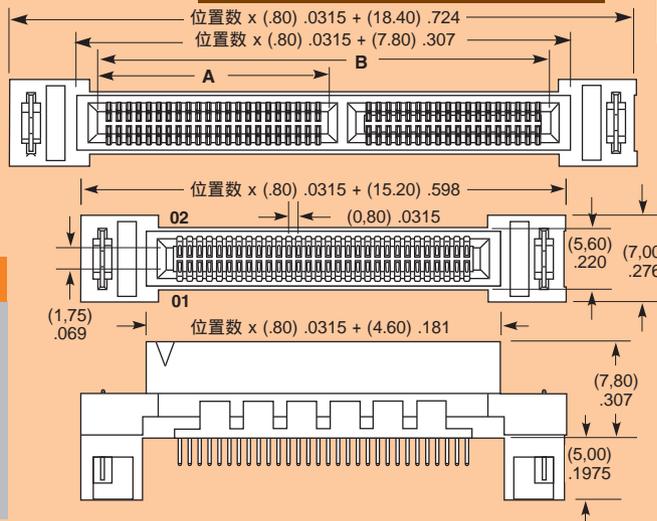
**HSEC8** - **1** 每排位置数 - **01** 电镀选择 - **D** - **EM2**

配接:  
(1,60mm) 0.62" 厚度的卡、EEDP、HSC8

**10, 20, 30, 40, 50, 60**

**-S**  
= 触点镀 30μ" (0,76μm) 的金, 焊尾镀雾锡

**-EM2**  
= (1,60mm) .062" 厚度的 PCB



每排位置数	A	B
40	(18,90) .744	(36,60) 1.441
50	(22,90) .902	(44,60) 1.756
60	(26,90) 1.059	(52,60) 2.071



## 还提供

有电极标记, 用于与 EEDP 系列双轴线缆配接

连接器	线缆
HSEC8-113	EEDP-08
HSEC8-125	EEDP-16
HSEC8-137	EEDP-24
HSEC8-149	EEDP-32

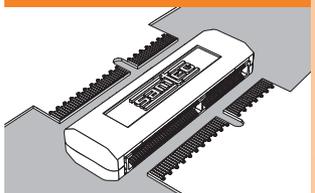
## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 [www.samtec.com?DEC8](http://www.samtec.com?DEC8)

绝缘材料:  
黑色 ABS  
触点:  
镀铜  
电镀:  
在 50μ" (1,27μm) 镍上镀金或锡  
额定电流:  
在 95°C 至 125°C 时为 3.1A  
工作温度:  
-55°C 至 +125°C  
符合 RoHS 规范要求: 是



## 应用



注: 有些长度、式样和选择为非标准型, 不可退换。

**DEC8** - **1** 每排位置数 - **引线样式** - **电镀**

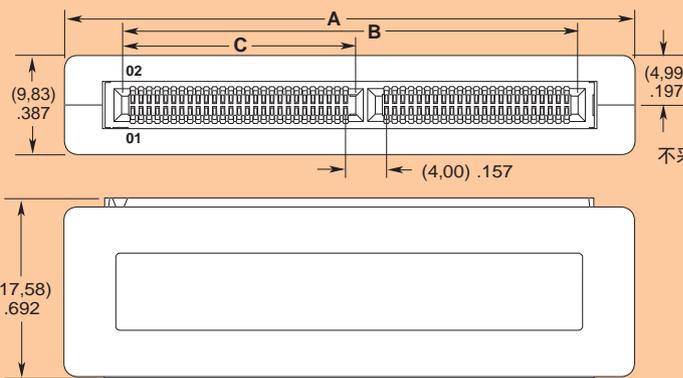
配接:  
(1,60mm) .062" 厚度的卡、HSC8

**40, 50, 60**

**-01**  
= (1,60) .062" 卡厚度

**-S**  
= 触点镀 30μ" (0,76μm) 的金

注: 提供其它镀金选择。请联系 Samtec。



不采用模制品, 实现透明性



每排位置数	A	B	C
40	(47,75) 1.880	(36,60) 1.441	(18,90) .744
50	(55,75) 2.195	(44,60) 1.756	(22,91) .902
60	(63,75) 2.510	(52,60) 2.071	(26,90) 1.059